

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	阿布扎比投资局 (ADIA): Rashed G. Almuhairi Mohammed Ahmed Ali Alnuaimi Mohammed Mubarak Alhemeiri Falah Alahbabi Hong Leng Chuah Chuang Tian Peng Yang Chung Yan Cheuk
时间	2023 年 10 月 24 日 09:00-10:30
地点	北京经济技术开发区科创八街 21 号院 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 205 会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：杨云春 副总经理、首席科学家：Yuan Lu 董事、副总、董秘、CFO：张阿斌 瑞典 Silex 董事：聂铁轮 赛莱克斯北京首席技术官：李云飞 高级投融资经理：邹瑶萍 证券事务专员：刘妍君
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：工厂参观及公司介绍 赛微电子组织阿布扎比投资局团队参观了北京 FAB3 园区基础设施以及 MEMS 产线洁净间。公司控股子公司赛莱克斯北京首席技术官李云飞介绍了工艺流程、关键技术及硬件设备。

赛微电子董事长、总经理杨云春，副总经理、首席科学家 Yuan Lu，瑞典 Silex 董事聂铁轮，赛莱克斯北京首席技术官李云飞回答了阿布扎比投资局团队所关心的问题。

赛微电子董事、副总、董秘、CFO 张阿斌介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。

赛微电子专注 MEMS 芯片制造主业，持续提升境内外产线的产能、利用率及良率，公司看好智能传感行业的未来发展空间，同时对自身的芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。

第二部分：上市公司解答提问，主要如下：

1、请介绍公司 MEMS 业务的基本情况。

答：公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路芯片晶圆制造厂商，也是拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业芯片晶圆制造商。公司目前拥有多座中试平台及量产工厂，业务遍及全球，服务客户包括国际知名的光刻机、DNA/RNA 测序仪、红外热成像、计算机网络及系统、元宇宙、硅光子、AI 计算、ICT、新型医疗设备巨头厂商以及各细分行业的领先企业，涉及产品范围覆盖了通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司同时正在打造先进的晶圆级封装测试能力，致力于为客户提供从工艺开发、晶圆制造到封装测试的系统化高端制造服务，努力发展成一家国际化经营的知名半导体制造领先企业。

公司主营业务 MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统) 工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及境内外持续扩张的 8 英寸成熟产能。公司在 2019-2022 年全球 MEMS 纯代工厂商排名中均位居第一。

公司在 MEMS 代工领域运营超过 20 年，具有雄厚的技术实力以及丰富的量产经验，经过 500 余项产品开发及量产实践的积累，在市场需求波动时期仍能够把握通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等各类应用领域的商业机会。目前，公司在瑞典拥有一座成熟运转的 MEMS 晶圆工厂，内含两条 8 英寸产线，并拥有可扩充产能的半导体产业园区；在北京拥有一座具备规模产能的 MEMS 晶圆工厂，内含一条 8 英寸产线；同时正在深圳新建一条 8 英寸中试产线。

2、请问公司 MEMS 业务的客户分布情况如何？

答：公司 MEMS 客户遍布全球，从北美科技之都到英伦学术重镇，从欧洲制造强国到亚洲新兴经济，从尖端生命科学到日常娱乐消费，从成熟行业巨头到创新创意团队，产品覆盖了通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多领域。公司欢迎与全球各领域客户、科研机构及高等院校开展技术与业务合作。

3、请介绍 MEMS 产业链包括哪些环节，如何分工协作？

答：MEMS 行业产业链上游为芯片设计环节，MEMS 设计公司首先对产品功能、性能及结构等进行研发设计；中游为 MEMS 传感器的制造环节，一般由芯片设计公司完成设计后交由第三方晶圆厂制造；下游为封装测试环节，一般由设计公司委托 MEMS 封装工厂进行封装、测试。此外 MEMS 行业还存在 IDM 厂商，即垂直整合制造，业务覆盖设计、制造、封装测试，销售自有品牌。

公司 MEMS 业务目前主要处于制造环节，上连产品设计，下接产品封测，是 MEMS 产业链中必不可少的一环。由于 MEMS 产业发展趋势以及自身发展战略需要，依托公司在 MEMS 代工制造领域的全球领先竞争优势，公司也正积极在 MEMS 产业链

向下游进行延伸拓展，公司正在建设 MEMS 先进封装测试能力。

4、请介绍公司供应链方面的情况，在当前国际环境下是否存在供应风险？

答：因产线建设及业务发展需要，公司近年来均在成批次或整线采购半导体设备，相关工作进展顺利。同时，为应对日益复杂的国际环境以及不排除未来的措施升级及扩大化，公司一直在加大关键原材料及生产工艺设备的采购及储备力度，同时积极加强与本土自主可控厂商的合作。随着国内材料、设备厂商的实力逐步增强，公司北京 FAB3 及后续在境内新建的产线，均将不断加大本土采购供应，进一步提高国产化比例。公司境外产线不存在供应链方面的此类挑战。

5、请问公司如何看待 MEMS 的市场规模？

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代，拥有良好的发展前景。

根据 Yole Development 的研究预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2021 年的 136 亿美元增长至 2027 年的约 223 亿美元，复合增长率（CAGR）达 9%，通讯、生物医疗、工业汽车及消费电子的应用增速均非常可观，其中通讯领域的复合增长率高达 25%。预计到 2026 年，10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频 MEMS（40.49 亿美元）、MEMS 惯性器件（40.02 亿美元）、压力 MEMS（23.62 亿美元）、麦克风（18.71 亿美元）

	<p>以及未来应用（13.63 亿美元）。</p> <p>由于公司自身 MEMS 业务突出的竞争优势，近年来所取得的复合增长率远远超过了行业平均增速，这也是我们持续扩充产能的信心来源，希望能通过新增产能与市场需求相结合，将公司所积累的工艺优势充分发挥出来。作为一家具备全球一流水平的专业芯片制造厂商，我们需要做的是持续不断地丰富和提升芯片制造工艺水平、持续不断地在全球范围内扩充中试及规模产能，顺应万物互联与人工智能时代的发展及需求爆发。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 24 日